

## 河北省承担的国家国际科技合作项目“LED倒装芯片胶粘工艺技术的联合研发”通过验收

日期：2014年09月10日      河北省科技厅

近日，受科技部国际合作司委托，河北省科技厅组织专家对河北大旗光电科技有限公司承担的“LED倒装芯片胶粘工艺技术的联合研发”进行了验收。通过审阅项目技术资料、现场查看、质疑答辩等程序，该项目得到了省内外技术专家的高度评价，并顺利通过验收。

该国际科技合作项目通过与日本大桥制作所合作，对LED芯片倒装胶粘新工艺、高性能的散热基板、各向异性导电胶制备等关键技术进行了研究，开发了LED倒装芯片胶粘新工艺；采用LED倒装芯片胶粘封装工艺的COB光源比正装封装COB光源在同等面积下多容纳了30%以上的芯片，总光通量提高了50%以上；研发的专用基板导热系数达到了386 W/m.K，极大地改善了散热性能；申请发明专利1项，获得实用新型专利3项。通过开展国际科技合作，攻克了LED倒装芯片胶粘等多项技术难题，建立了稳定有效的合作机制，在企业内形成了稳定的研发团队。

该项目有效解决了国内现有LED正装芯片封装技术导热性差、导电性差、出光效率低、可靠性较差、单位面积可封装的芯片数量较少等技术问题。LED倒装芯片胶粘工艺成熟后将在LED封装领域形成一条新的技术路线，是一次重大技术突破，填补了国内LED倒装芯片胶粘工艺的空白。此项工艺技术的应用将大规模替代正装键合工艺，实现LED封装技术的升级换代。

 打印本页 ▶

 关闭窗口 ▶